

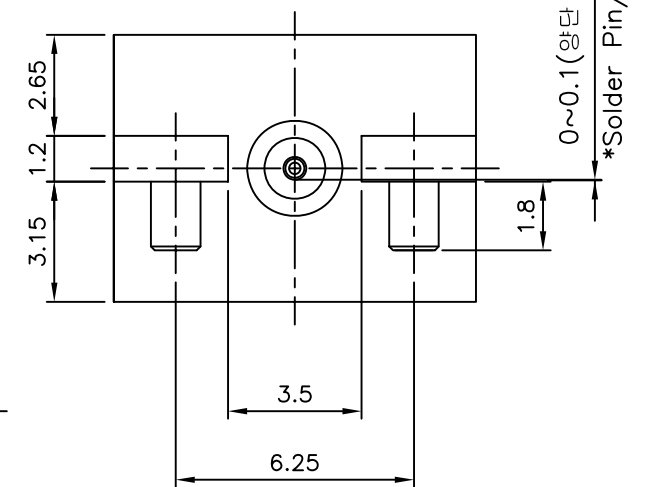
*포장사양
2Page 참조 할 것.

REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	H.J.LEE	I.C.KIM	2015.12.01.
1	[설번No.201601-0008] 특성문제로 인한 PIN 간격 수정	H.J.LEE	I.C.KIM	2016.01.13.
2	[설번처리No.201604-0005] 고객사 요청으로 인한 BODY 다리, 반 길이 변경 및 테프론 내경치수 변경	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.04.20.
3	[설번처리No.201606-0006] 조립성 및 특성개선을 위한 PIN, 테프론 CODE 변경	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.06.20.
4	고객사 요청으로 인한 ANTENNA부 다리길이 변경 2.0 -> 1.0	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.07.28.
5	포장사양관련 주기 및 2Page 추가	C.K.KIM	I.C.KIM	2016.10.28.

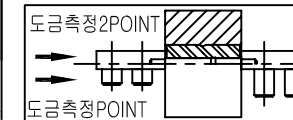
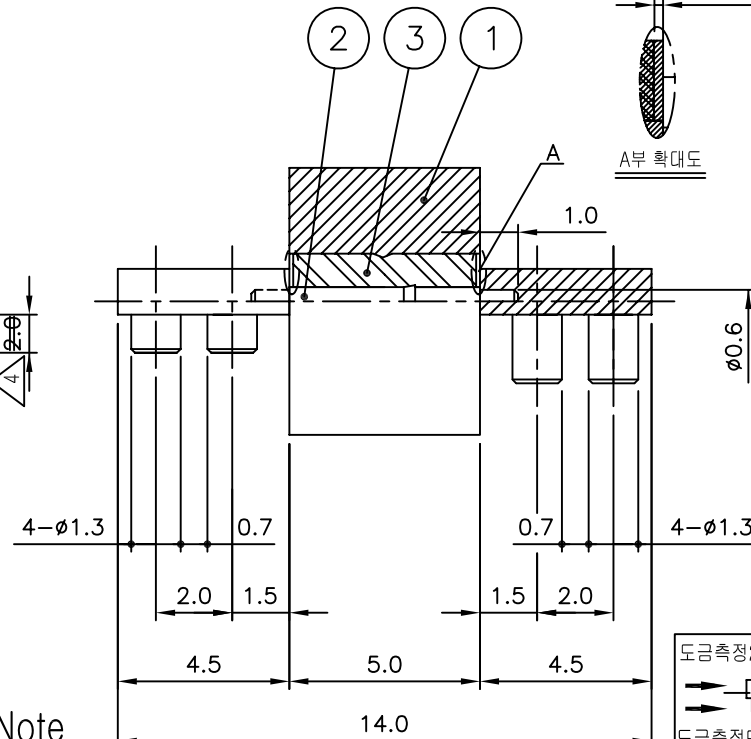
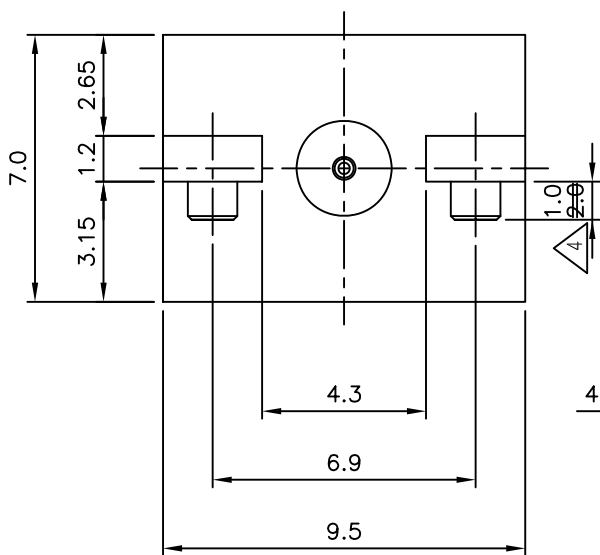
0.1 (양단 동일)

*Solder Pin/Ground gap
검사시 비전검사 할 것.

RADAR 부



ANTENNA 부



도금업체

태봉금속(하지동/Ni) -> 삼현도금(Gold)

Note

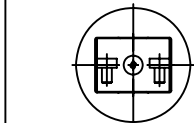
1.BODY 도금검사 성적서상 두께 도금 양품으로 조립 할 것.

- 1.1 도금 규격 Gold Plate
- 1.2 도금 두께 Cu : $15\mu\text{m} \pm 5\mu\text{m}$
Nickel : $3\mu\text{m}$ 이상
Gold : $0.05\mu\text{m}$ 이상

2.RF특성 확인방법은 ERP 첨부파일 참조 할 것.

조립 방법

- 1.BODY를 받침 하 JIG에 끼운다.
- 2.테프론을 BODY에 조립한다.
- *테프론 조립시 A부 확대도 참조 할 것.
- 3.PIN을 BODY+테프론에 조립한다.

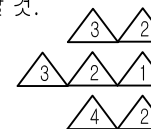


CN03516-7/2

CEQ00448-1/1

ZEQ00259-N/1

Conn+받침지그 결함도



3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN02654-N/4
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate	DCT03626-5/3
1	BODY	1	ZnDC	Note1 참조	DBD04061-5/4 DBD04061-5/3
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal	DATE 2016. 10. 28.	
	Angle	APPROVED BY	I.C.KIM
MATERIAL		CHECKED BY	
		DRAWN BY	C.K.KIM
FINISH		SCALE	5/1
		UNIT	mm

 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017		TITLE	
		M200W-SMA-PCB JS-4R (ANTENNA 부 다리길이 1mm)	
DWG NO.	CN03516-7/3	REVISION	5
SHEET	1 of 1		



포장사양

1. Tray code : CPA00095-N/1 에 사진과같이 1구에 1ea씩 포장한다.
*포장된 Tray는 간지를 깔지 않고 Tray끼리 겹쳐 포장 할 것.

2. BOX code : DBX00034-N/1 한 BOX에는 21Tray씩 포장한다.
*맨 윗트레이는 두껍용 공Tray 일 것.

1Tray = 제품 100ea

1Box = 제품 2000ea (20Tray)